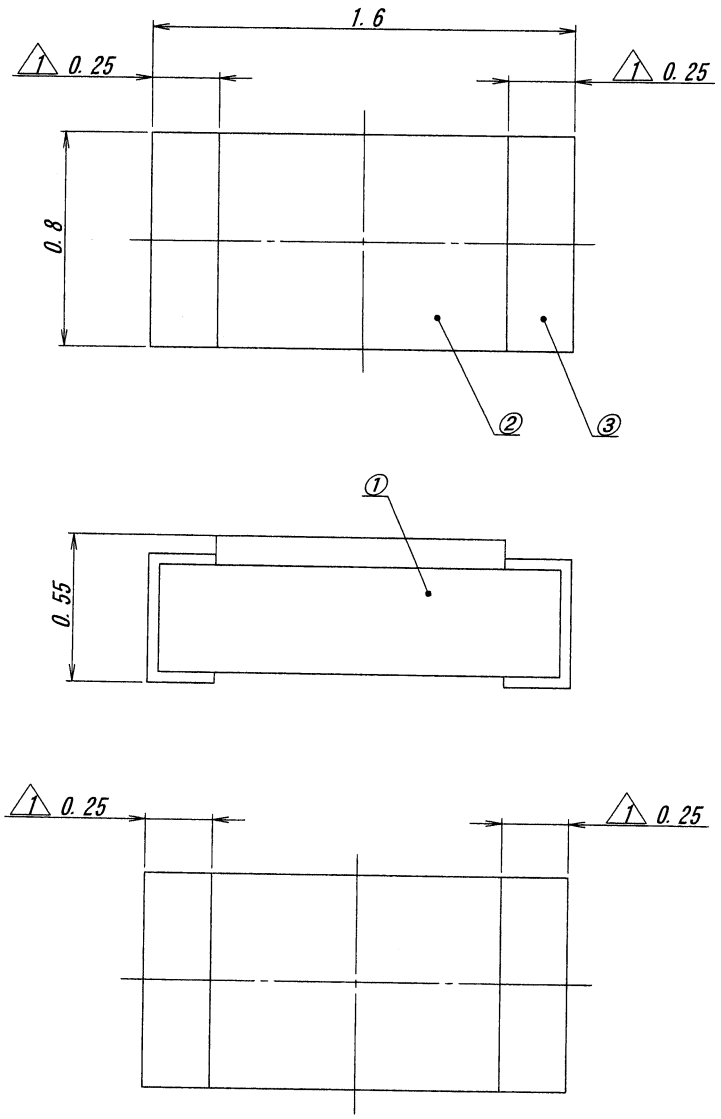
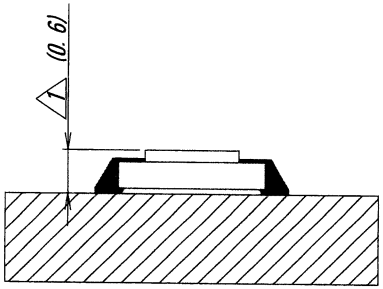
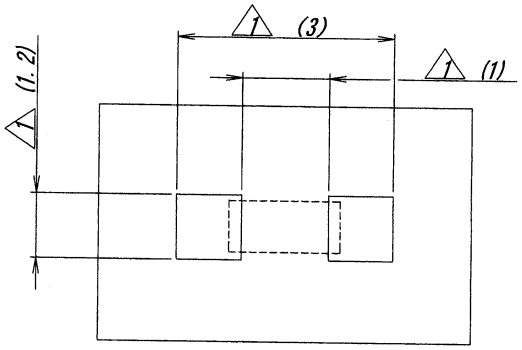




実装状態

After Mounted and Soldered



参考ランドパターン

Reference Land Pattern

ISSUED
'11.6.17
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△	39722	REVICED	T, S	Y, S	'10.4.7
△	—	RELEASED	T, S	Y, S	'09.4.2

MATERIAL 材質

①セラミックス CERAMICS
②樹脂 RESIN
③電極 ELECTRODE

FINISH 仕上げ

③下地；ニッケルめっき UNDER Ni PLATE
表面；スズめっき Sn PLATE

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM 寸法 ± 0.2
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 ≠

UNIT 単位 mm

DR '10.4.7 T, Saito
DSN '09.4.2 T, Saito
CHK '10.4.7 Y, Sugaya
APP '09.4.2 Y, Sugaya

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称 1608 Size
6802シリーズ ESDプロテクターチップ
SERIES 6802 ESD PROTECTOR CHIP

EDP No

PARTS No 部番 6802-01B

DWG No 図番 IMSA-6802-01B

REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので、当社の書面による許可なしに使用してはなりません。